



# た か だ こ ら む

## セミコン・ジャパン 2008 / インターネブコン出展報告

新規事業推進テーマの一つである「超音波切断装置」の販売と市場への PR 活動，ならびに装置開発のための市場ニーズ収集を目的に，セミコン・ジャパン 2008 とインターネブコンへ出展したので，その概要を報告する．

### 1．展示会の概要

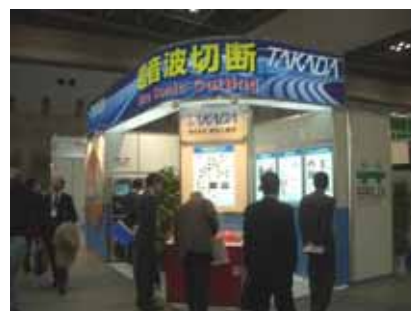
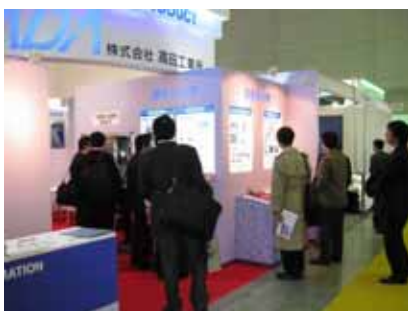
	セミコン・ジャパン 2008	インターネブコン・ジャパン 2009
開催地	幕張メッセ（千葉県千葉市）	東京ビッグサイト（東京/台場）
開催期間	2008 年 12 月 3 日～5 日（3 日間）	2009 年 1 月 28 日～30 日（3 日間）
来場者数	約 97,000 名	約 60,000 名
ブース来場者	約 500 名	約 500 名

セミコン・ジャパンは，半導体を中心としたマイクロエレクトロニクス製造を支える装置・材料産業の総合イベントであり，世界最大級の展示会やシンポジウムとともに，国際標準化会議も開催されるなど半導体業界の潮流を生み出している．

当社も 2000 年以降継続して出展しており，業界内での知名度向上と「枚葉処理装置」や「真空ポンプ劣化予兆診断システム（VPMS）」などの新規のお客様の獲得につながっている．

インターネブコンは，エレクトロニクス製造・実装に関する多くの製品や技術が一堂に会する展示会で，同分野での市場開拓を目指す当社にとって絶好の PR 機会と捉え，初めての出展に至った．

両展示会とも，「断面観察用超音波切断装置」の商品 PR や，超音波切断に対するニーズ把握を目的として出展し，装置の実用性や超音波切断のポテンシャルの高さをアピールすることができ，また，多くのお客様にご来場頂いたことで貴重な情報を得ることができた．



### 2．展示会の反響と今後

今回多くのお客様と直接会話をさせて頂き，それぞれお客様が切断に関し何らかの課題を持っており，その解決策として超音波切断に寄せる期待の大きさを実感するとともに，当社が行うべき開発の方向性も明確になってきた．

また，出展に際しては招待状の配布はもちろんのこと，テレマーケティングによりお客様に対するアナウンスを直接行ったことや，展示会運営に対する対応マニュアルを準備したことなどが，大きな反響につながったものと考えている．今後も新規事業の戦略の一環として，展示会への出展を有効に活用していきたい．

前田 泰男（新規事業部）